

北京耐威科技股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

为满足公司发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向光大银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“光大银行”）申请不超过1亿元的综合授信额度，拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过5,000万元的综合授信额度，期限均为12个月，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

针对公司向光大银行申请的授信事项，公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司拟为公司提供连带责任担保，同时公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与光大银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”）拟向宁波银行申请不超过2,000万元的综合授信额度，期限12个月，具体数额以该子公司根据资金使用计划与宁波银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

针对瑞通芯源向宁波银行申请的授信事项，公司拟提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以瑞通芯源根据资金使用计划与宁波银行签订的最终协议为准，瑞通芯源免于支付担保费用。

公司董事会授权公司及子公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述贷款相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 25 日